amova
アモーヴァ・アセットマネジメント

アセットマネジメント(am)を
ムーヴ(move)する

販売用資料
2026年9月

JAPAN
SEMICONDUCTOR

ジャパン半導体株式ファンド
ジャパン半導体株式ファンド(予想分配金提示型)

追加型投信／国内／株式

設定・運用は

アモーヴァ・アセットマネジメント

2025年9月1日付で、日興アセットマネジメント株式会社から社名変更しました。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長(金商)第368号
加入協会:一般社団法人資産運用業協会

日本の半導体関連企業には今、大いなる成長機会が訪れている

私たちの生活になくてはならない半導体、
その市場は今後も世界的に拡大すると見込まれている。

近年、半導体分野における日本企業の勢いが失速してきたのは事実。
しかし、足元では再び大きな成長の機会が訪れており、
日本企業の持つポテンシャルは世界的に見て高水準と言えよう。

国を挙げての取組みが進む中、日本企業が持つ強みを存分に活かし、
大きな成長を遂げる可能性が高まっている。

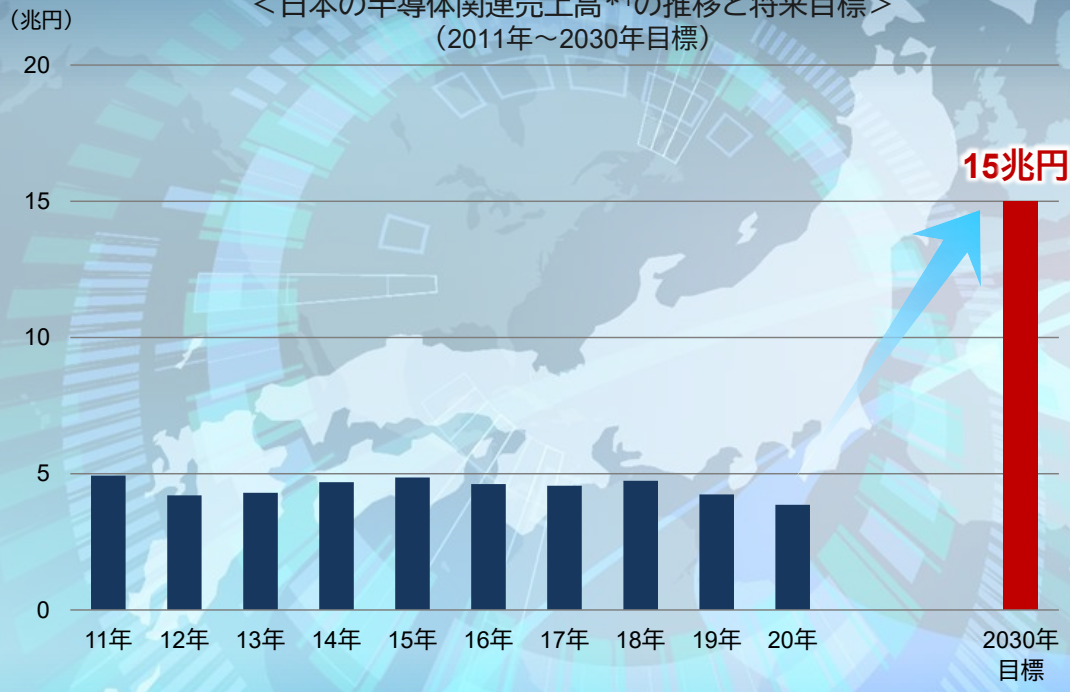
※ 半導体関連企業には、半導体製造装置や半導体材料の供給を行なう企業、半導体の製造にかかわる企業のほか、半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺産業の企業などがあります。

日本の半導体戦略と意欲的な目標

■ 2021年から本格化した日本の半導体戦略は着実な進展を見せています。政府は2023年4月に半導体関連売上高の目標を引き上げ、2030年に15兆円という意欲的な数字を掲げました。

■ 政府は半導体戦略の中心に国内の生産能力強化を据えており、足元で計画されている製造拠点の稼働によって、10年間でGDPが最大4.2兆円押し上げられるとの試算を明らかにしています（2023年現在）。

＜日本の半導体関連売上高*1の推移と将来目標＞
（2011年～2030年目標）



＊1 日本国内で半導体や半導体製造装置などを生産する企業の売上高合計
2011年～2019年は経済産業省「工業統計調査」、2020年は経済産業省「製造業事業所調査」の品目別出荷額の値を集計。出荷額については、半導体関連（半導体素子、光電変換素子、集積回路）の合計額。
上記データをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

先端分野を筆頭に、半導体産業への中長期的な取組みが進行中

＜半導体・AIに関する投資促進策の概要＞
（2024年11月決定）

【AI・半導体産業基盤強化フレーム】
2024年からの10年間で**50兆円**を超える官民投資を引き出す
⇒ **その呼び水として、2030年度までに10兆円以上の公的支援を実施予定**

＜先端ロジック半導体の国内基盤に関する取組み＞
（2026年7月現在）

先端ロジック半導体戦略
JASM*2
先端ロジック半導体の国内製造基盤確保
2024年12月より第1工場で量産開始、第2工場は2027年12月の稼働をめざす
政府による支援額累計：約**1.2**兆円

次世代半導体プロジェクト
Rapidus*3
世界最先端の2ナノメートル半導体の量産をめざす
2025年4月に試作ライン稼働、2027年度後半の量産開始をめざす
政府による支援額累計：約**2.9**兆円
（27年度までの予定分を含む）

＊2 世界最大級の半導体製造企業であるTSMC（台）が過半数を出資する子会社。ソニーセミコンダクタソリューションズ、デンソー、トヨタ自動車が少数株主として参画。
＊3 キオクシアやソニーグループ、ソフトバンクなど国内8社が合計約73億円を出資して22年に設立。26年には、政府が約1,000億円を、民間からは既存株主8社のほか、ホンダやキヤノン、富士通など24社が合計約1,676億円を出資。
経済産業省の資料や会社情報、報道などをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

※ 記載の銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。
※ 上記は過去のものおよび目標、予定であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

半導体市場は世界的に成長が加速する見込み

■「半導体」とは、電気を通す「導体」と、電気を通さない「絶縁体」の中間の性質を備えた物質をさします。また、半導体を材料に用いた集積回路(IC)部品などの総称としても使われています。

■ 世界の半導体市場は、スマートフォンやPC、データセンターなどに加え、EV(電気自動車)や生成AI(人工知能)、フィジカルAIといったイノベーションの拡がりによって、中長期的に成長が加速すると見込まれています。

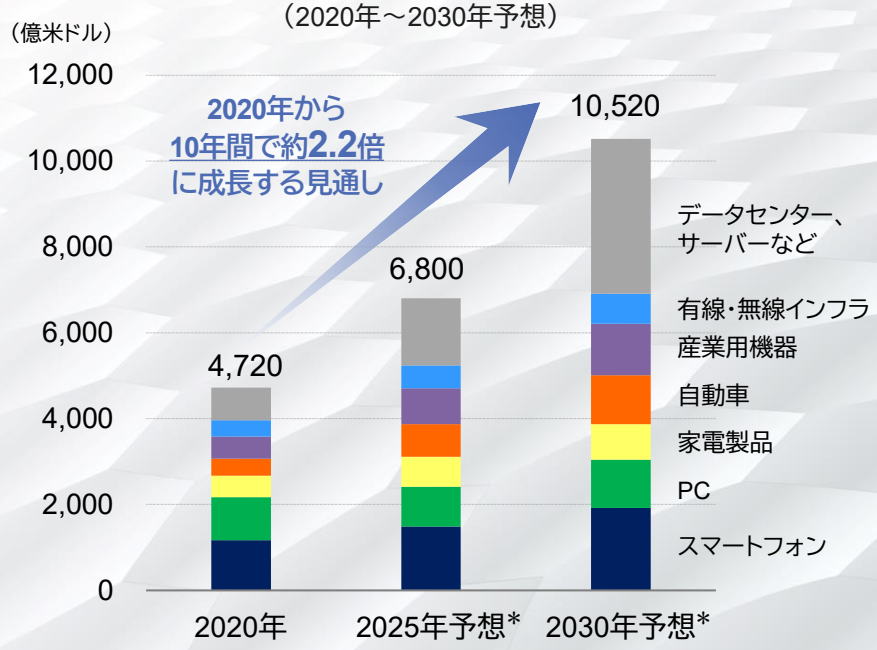
※半導体の主な種類や機能などについては、後述の「半導体産業の構造と主な半導体の役割」のページをご参照ください。

デジタル社会において必要不可欠な半導体は、今後の成長加速が期待されている

半導体は、様々な産業のデジタル化を支えている

※写真、イラストはイメージです。

＜世界の半導体市場規模(分野別)＞
(2020年～2030年予想)



＊2025年現在の予想データ
ASMLのデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

※ 上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

日本企業の持つ大きな成長機会

■ 日本企業は「半導体製造装置」と「半導体材料」の分野で世界的な優位性を有しており、世界で半導体の中長期的な需要拡大が見込まれる中での成長機会は大きいと考えられます。また、コロナ禍を受けた深刻な半導体不足を経て、半導体は国の安全保障をも左右する戦略物資に位置付けられるようになりました。日本でも安定供給をめざした国家事業として、大規模な取組みが始動しています。

＜各市場における企業の国・地域別シェア＞
（2022年現在）

半導体製造装置市場

半導体材料市場

※四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。
※出資比率が50%以上となる企業の国籍／地域に準じます。
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）2023年度調査報告書「2023年度　日系企業のモノとITサービス、ソフトウェアの国際競争ポジションに関する情報収集」をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

＜日本の半導体・AI関連予算の推移＞

政府は26年度以降、半導体・AI関連の予算を補正予算から当初予算（本予算）へと切り替え、毎年1兆円程度を安定的に支援することをめざす

年度	予算規模
2021年度 補正予算	約7,740億円
2022年度 補正予算	約1兆3,036億円
2023年度 補正予算	約1兆9,867億円＊
2024年度 補正予算	約1兆5,228億円
2025年度 補正予算	約3,000億円
2026年度 当初予算	約1兆2,390億円

＊既存基金の残金を含む
経済産業省の資料をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

＜日本の優位性の例＞

台湾に集中する半導体製造拠点の分散化を巡り、新たな拠点として日本の優位性が注目を集める

※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

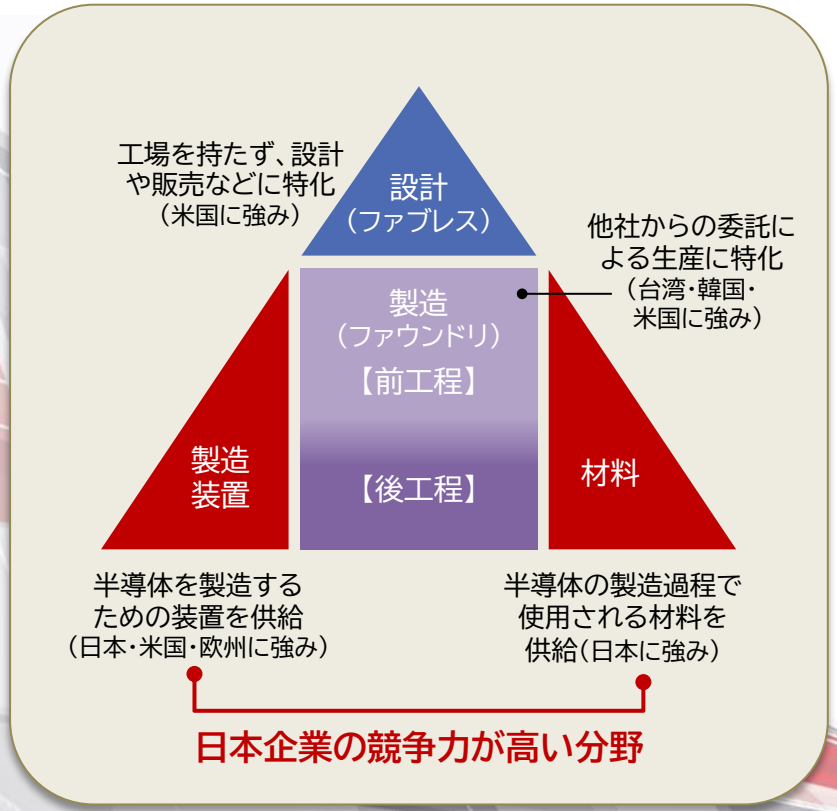
※写真、イラストはイメージです。

半導体産業の構造と主な半導体の役割

■ 半導体産業は大きく4つの分野に分かれており、日本企業が高い優位性を有するのは「製造装置」と「材料」の分野とされます。
また、現在は台湾に拠点が集中する「製造」においても、日本企業の活躍する場は多くみられます*1。

*1 詳細は後述の「半導体の製造にかかわる企業」のページをご参照ください。

＜半導体産業の構造＞



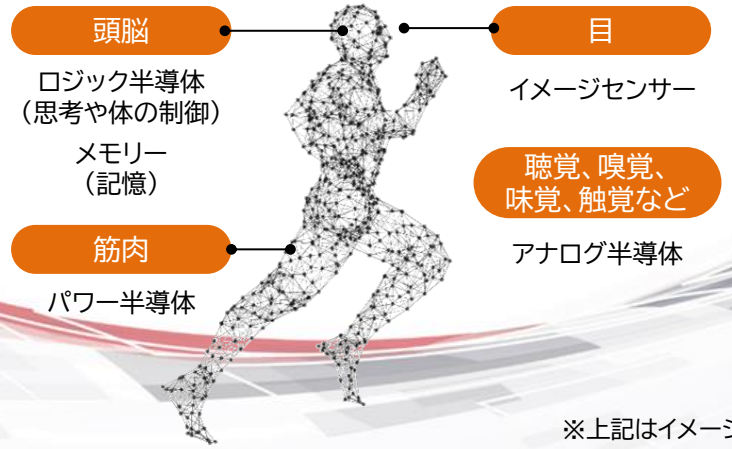
※上記はイメージです。

＜半導体の主な種類＞

種類	機能や用途	搭載される製品などの例
ロジック半導体	データ処理、機器の制御	スマートフォン、PC
メモリー	データ保存	スマートフォン、PC
イメージセンサー	レンズから取り込んだ画像をデジタルデータに変換	スマートフォン、EVなどの自動車、IoT*2
アナログ半導体	音や光、温度などの情報をデジタルデータに変換	PC、EVなどの自動車
パワー半導体	電圧を制御し、機器を省エネ化	EVなどの自動車、発電機器

*2 様々なモノがインターネットに繋がる仕組み。

＜半導体の役割を人に例えると＞



※上記はイメージです。

当ファンドの投資対象となる3つのカテゴリー

■ 当ファンドでは、拡大する半導体需要を支える日本の半導体関連産業を、主に3つの投資カテゴリーで捉えます。

カテゴリーⅠ
半導体製造装置や半導体材料の供給を行なう企業

高い競争力を持ち、世界の半導体産業において重要な役割を果たす半導体製造装置および半導体材料企業

代表的なビジネスの例

カテゴリーⅡ
半導体の製造にかかわる企業

EVや自動運転、省エネ(CO_2削減など)といった長期的な成長トレンドに貢継する国産半導体の製造や設計、販売にかかわる企業

代表的なビジネスの例

カテゴリーⅢ
半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺企業

今後、国内での増加が見込まれる半導体関連の工場建設や改築によって恩恵を受ける企業

代表的なビジネスの例

※ 投資カテゴリーはアモーヴァ・アセットマネジメントが考える分類です。
※ 当ファンドの投資カテゴリーは上記に限定されるものではなく、将来、変更となる可能性があります。

※写真、イラストはイメージです。

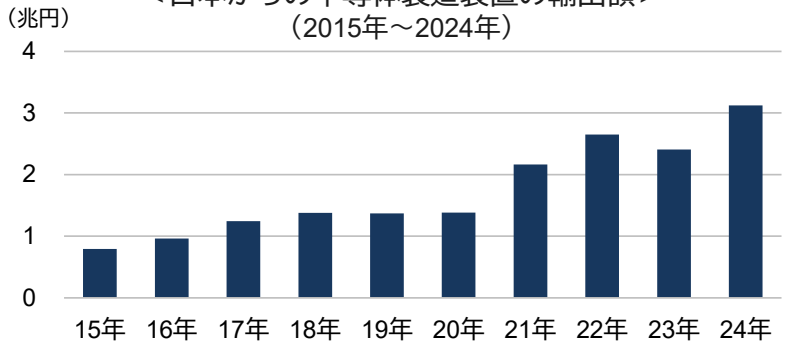
半導体製造装置や半導体材料の供給を行なう企業

■ 半導体サプライチェーンにおいて重要な役割を担う日本企業には、世界的な需要拡大を背景に、大きな成長機会が訪れると期待されます。

■ 半導体の製造工程において、技術力に優れた日本企業の活躍の場は多く見られます。特に技術革新の余地が大きい「後工程」における日本企業の技術水準は高いとされており、更なる競争力の向上が期待されます。

半導体製造装置の輸出額は近年拡大傾向

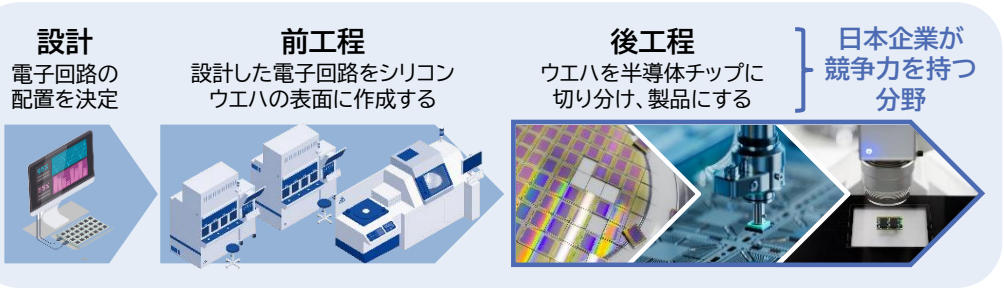
＜日本からの半導体製造装置の輸出額＞
（2015年～2024年）



税関のデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

技術力や対応力に優れた日本企業の優位性は相対的に高い

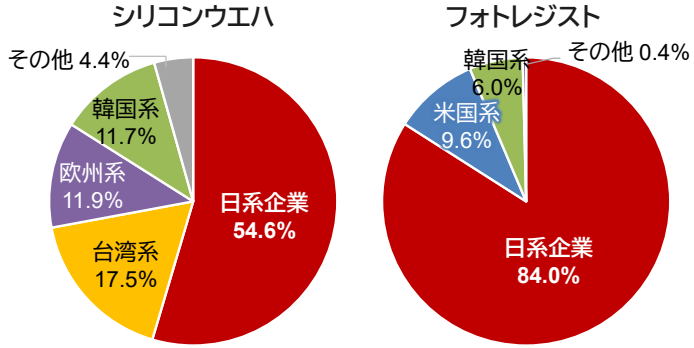
＜半導体の製造工程＞



※上記はイメージです。

半導体材料分野でも日本企業は優位性を発揮

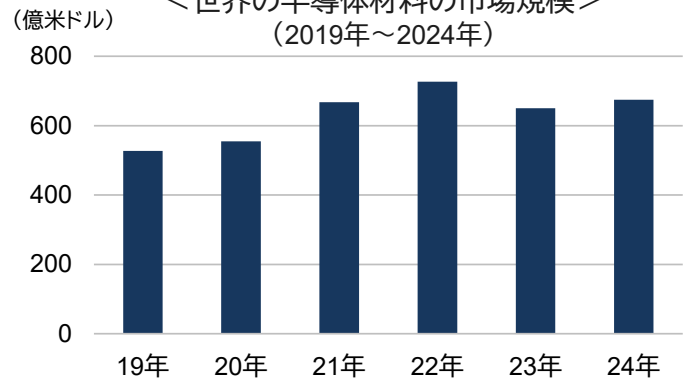
＜各半導体材料市場における企業の国・地域別シェア＞
（2022年現在）



※四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。
※出資比率が50%以上となる企業の国籍／地域に準じます。

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）2023年度調査報告書「2023年度 日系企業のモノとITサービス、ソフトウェアの国際競争ポジションに関する情報収集」をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

＜世界の半導体材料の市場規模＞
（2019年～2024年）



Semiconductor Equipment and Materials International のデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

※写真、イラストはイメージです。

半導体の製造にかかわる企業

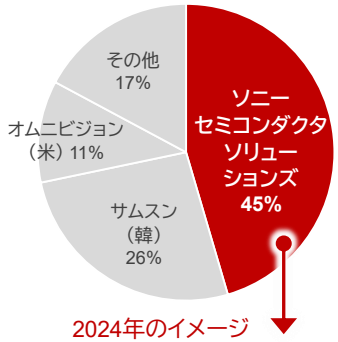
■ 半導体の製造において、日本企業が優位性を発揮する分野は多くみられます。EVや自動運転、IoTなどのテクノロジーが中長期的に拡大するとみられる中、日本企業がこうした分野で世界をリードする可能性は高いと考えられます。

■ 現在は海外で生産されているロジック半導体などの先端分野に関し、政府は中長期的な国家戦略として取り組む姿勢を見せています。

今後の拡大余地が大きい分野での中長期的な活躍が期待される

＜半導体の種類別企業シェア＞

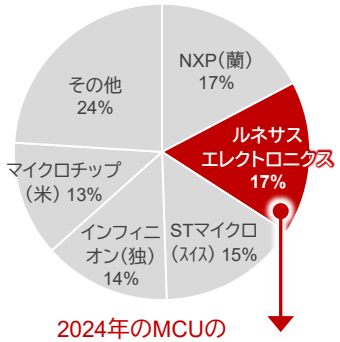
スマートフォン用イメージセンサー
（2021年現在）



2024年のイメージセンサー全体の世界シェアは53%（同社発表値）

主な用途
スマートフォン、IoT、自動運転など

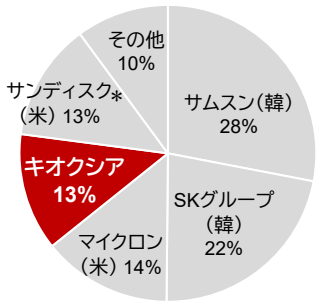
マイコン（MCU）
（2021年現在）



2024年のMCUの世界シェアは全体で3位、車載向けでは2位（同社発表値）

主な用途
EVなどの自動車、家電など

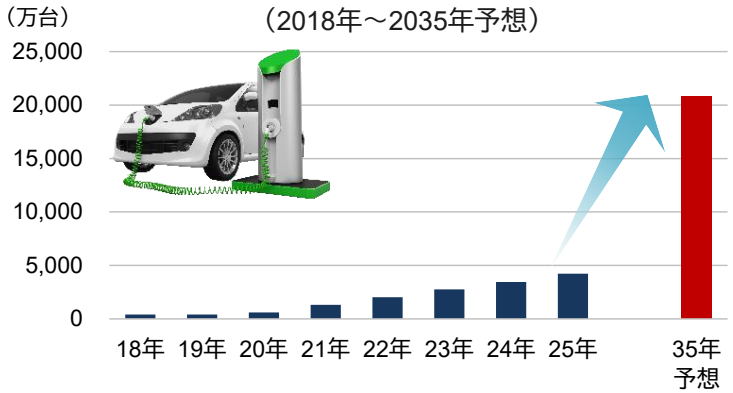
NANDフラッシュメモリ
（2025年12月現在）



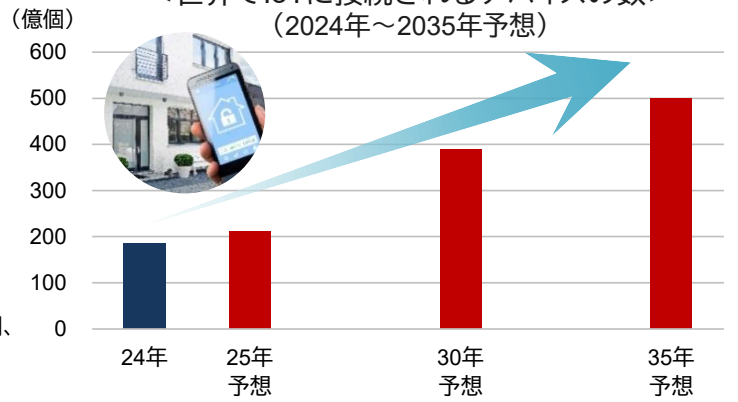
＊旧ウエスタンデジタル

主な用途
PC、IoT機器、クラウドストレージなど

＜世界のEV販売台数＞
（2018年～2035年予想）



＜世界でIoTに接続されるデバイスの数＞
（2024年～2035年予想）



※2025年現在の予想データ

※ 企業名は信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが和訳および省略したものであり、実際と異なる場合があります。
※ 四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。
（上円グラフ）イメージセンサー：Strategy Analytics、マイコン（MCU）：Infineon、NAND フラッシュメモリ：DRAMeXchange; TrendForce、上記データをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

（右上グラフ）国際エネルギー機関、
（右下グラフ）IoT Analytics、
上記データをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

※ 記載の銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。
※ 上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。　※ 写真、イラストはイメージです。

【本資料の「お申込みに際しての留意事項」を必ずご覧ください。】

半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺企業

■ かつて、日本には大規模な半導体製造工場は限られていたものの、旺盛な需要や政府の後押し、海外企業による日本への投資強化などを受け、今後は関連工場の建設や稼働が加速すると見込まれます。それに伴ない、様々な工場設備の導入や保全管理、改築やメンテナンスなどの需要も高まると考えられます。

巨額の設備投資を支える大規模な支援策が始動

＜政府による主な支援対象と支援額＞
（2026年7月現在）

企業名	投資額	最大支援額
Rapidus	–	2兆6,040億円＊
JASM（第1、第2工場）	225億米ドル規模	1兆2,080億円
マイクロンメモリ ジャパン（複数案件合計）	2兆1,394億円	7,135億円
キオクシア	7,288億円	2,429億円
タワーパートナーズセミコンダクター	6,000億円	1,600億円

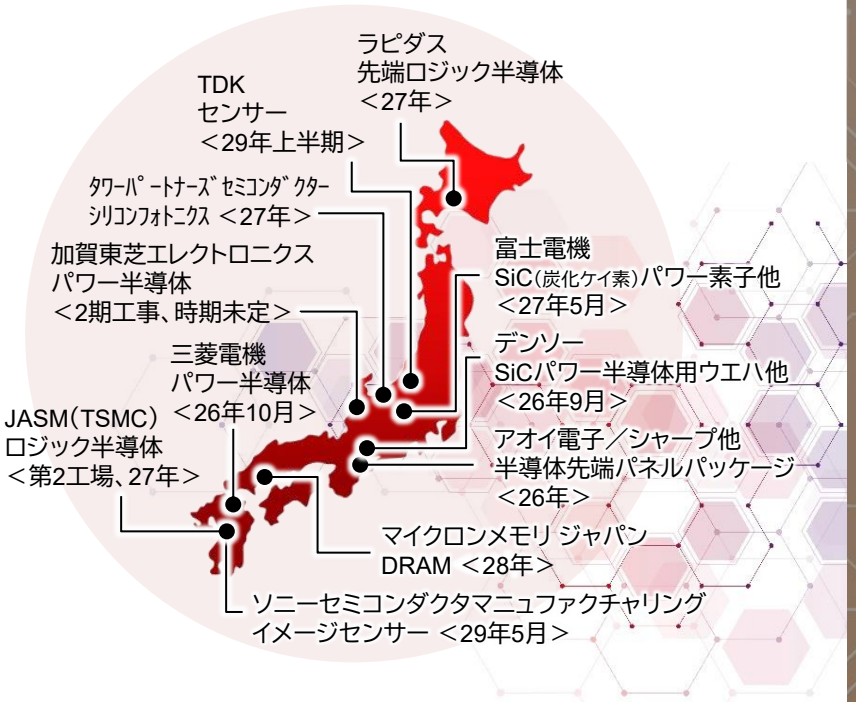
＊予定分は含まない。
経済産業省の資料などをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

＜恩恵が期待される周辺産業の例＞

※写真はイメージです。

半導体関連施設の稼働ラッシュが続く見込み

＜主な半導体関連施設の稼働予定＞
（2026年7月現在）



各種報道や企業の発表資料をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

※ 記載の銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。
※ 上記は過去のものおよび予定であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

(ご参考)半導体の製造工程

設計工程

回路・パターン設計

集積回路(IC)に必要な性能や機能の配置を決める

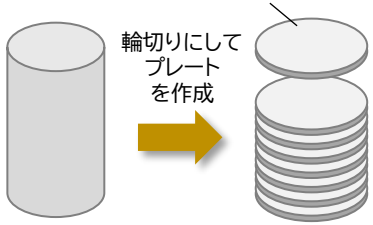
フォトマスク作成

透明なガラス板の表面に設計した回路パターンを描く。これがウエハに転写するための原板となる

製造工程(前工程)

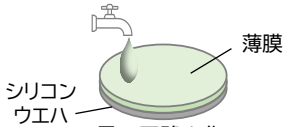
シリコンウエハ製造

超高純度の単結晶シリコン塊を製造



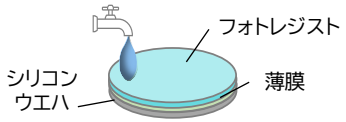
これが半導体デバイスの基盤となる

成膜



電子回路を作る基板となる薄膜の層を形成

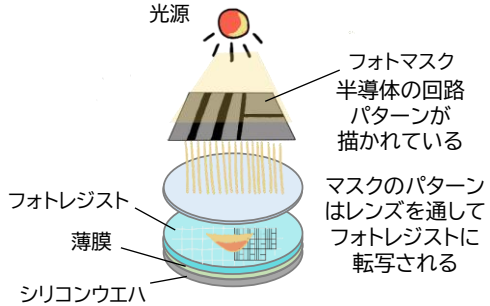
フォトレジスト塗布



回路パターンの転写用に感光剤であるフォトレジストを塗る

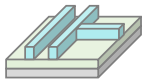
露光

フォトマスクを通じ、フォトレジストに特殊な光を当て、マスクのパターンを焼き付ける



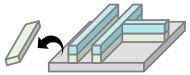
製造工程(前工程)

現像



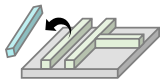
現像液をかけて余分なフォトレジストを溶かす

エッチング



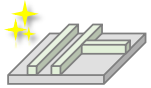
フォトレジストで形成されたパターンに沿って薄膜を加工する

レジスト剥離



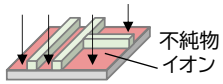
薄膜の上に残っているフォトレジストを取り除く

洗浄



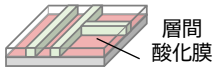
ウエハ上に残った汚れを落とす

不純物添加



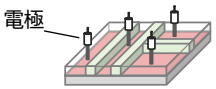
ウエハはほとんど電気を通さないので、不純物イオンを添加し半導体の性質にする

平坦化処理



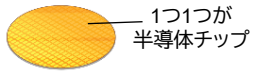
ウエハの表面を研磨し凹凸を平坦化する

電極形成



電極を配線するため銅などの金属を埋め込む

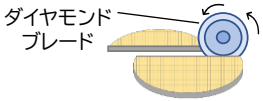
ウエハ検査



ウエハに形成された1つ1つのチップに対して、針を接触させて電気的に問題ないか検査する

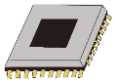
製造工程(後工程)

ダイシング(切断)



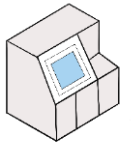
前工程で形成した集積回路を1つ1つチップとして切り出す

パッケージング



金属のフレームにチップを固定し、樹脂でパッケージングする

最終検査



異常がないか検査し、不良品を取り除く

完成

※フォトレジスト塗布から平坦化処理までの工程が何度か繰り返し行なわれます。簡素化のため、一部工程を省略しています。　※上記はイメージです。　各種資料をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

ファンドの特色

1 主として、わが国の金融商品取引所に上場されている半導体関連企業の株式に投資を行ないます。

- 半導体関連企業には、半導体製造装置や半導体材料の供給を行なう企業、半導体の製造にかかわる企業のほか、半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺産業の企業などがあります。

2 日本株式の調査・運用に精通したアモーヴァ・アセットマネジメントが運用を行ないます。

- 高い専門性を有したアナリストおよびファンドマネージャーによる徹底したボトムアップ・リサーチなどに基づき、運用を行ないます。

3 お客様の運用ニーズに応じて、「1年決算型」と「予想分配金提示型」の2ファンドからお選びいただけます。

※当資料において、「1年決算型」は「ジャパン半導体株式ファンド」を指します。

- 「1年決算型」は、毎年12月20日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
- 「予想分配金提示型」は、毎月20日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。各計算期末の前営業日の基準価額（支払済み分配金（1万口当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じて、原則として、以下の金額の収益分配を行なうことをめざします。

※初回決算は2026年7月とします。

各計算期末の前営業日の基準価額	分配金額（1万口当たり、税引前）
11,000円未満	基準価額の水準等を勘案して決定
11,000円以上12,000円未満	100円
12,000円以上13,000円未満	200円
13,000円以上14,000円未満	300円
14,000円以上	400円

- 分配金額は、毎決算時に、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。ただし、各計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合や、基準価額水準、市場動向などによっては、委託会社の判断により上記とは異なる分配金額となる場合や、分配を行なわない場合もあります。
- 基準価額があらかじめ決められた水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を行なうというものではありません。
- 分配金が支払われた場合、その金額相当分、基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配金額は変動する場合があります。
- あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

半導体の需要変化に加え、技術変化にも目を配る

■ 当ファンドでは、半導体産業の中長期的な需要の移り変わりや技術の進化に目を配り、産業構造の変化を的確に捉えることで、成長企業を見極めます。

技術の進化と需要の変遷

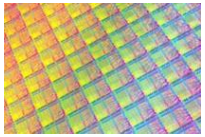
＊現実世界の情報をセンサーなどで認識し、状況に応じて自律的に行動できるAI。
※上記はイメージです。また、写真、イラストはイメージです。

半導体の先端技術の例

高性能化や多機能化、低消費電力化などに向けた技術が進展

微細化

1つの基板上に大量の回路を小さく作り込んで集積度を高める技術。近年は線幅が原子の大きさに近付いたことで微細化のペースが鈍化。

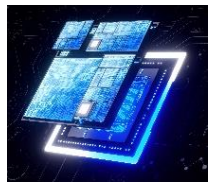


3次元構造化

更なる微細化が難しくなる中、性能を高めるために半導体の構造を立体化させるなどして3次元化を行なう、前工程の技術。

2.5次元／3次元パッケージ

性能や世代などが異なる複数の半導体チップを基板上に乗せて大規模化し、1つのパッケージに収める技術。水平および垂直方向への相互接続を行なうため、高い精度とすり合わせの技術力が必要とされる。



ポートフォリオの概要（2026年6月末現在）

＜市場別構成比率＞

市場	比率
プライム	95.3%
スタンダード	4.7%
グロース	0.0%
その他	0.0%

＜業種別構成比率上位＞

業　種	比率
電気機器	39.9%
機械	20.2%
化学	15.0%
建設業	9.0%
卸売業	4.6%
精密機器	2.7%
繊維製品	2.3%
非鉄金属	1.4%
ガラス・土石製品	1.1%
情報・通信業	0.9%

＜規模別構成比率＞

時価総額	比率
1兆円以上	55.6%
5,000億円以上1兆円未満	18.5%
2,000億円以上5,000億円未満	17.1%
2,000億円未満	8.9%

＜投資カテゴリー別構成比率＞

投資カテゴリー	比率
半導体製造装置・半導体材料企業	78.3%
半導体の製造にかかわる企業	10.1%
恩恵を受ける周辺企業	11.6%

＜組入上位10銘柄＞（銘柄数：62銘柄）

	銘　柄	業　種	投資カテゴリー	比率
1	アドバンテスト	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	5.98%
2	東京エレクトロン	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	5.97%
3	イビデン	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	4.68%
4	鹿島建設	建設業	恩恵を受ける周辺企業	3.38%
5	SCREENホールディングス	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	3.19%
6	扶桑化学工業	化学	半導体製造装置・半導体材料企業	2.65%
7	CKD	機械	半導体製造装置・半導体材料企業	2.63%
8	荏原製作所	機械	半導体製造装置・半導体材料企業	2.56%
9	四国化成ホールディングス	化学	半導体製造装置・半導体材料企業	2.46%
10	SMC	機械	半導体製造装置・半導体材料企業	2.36%

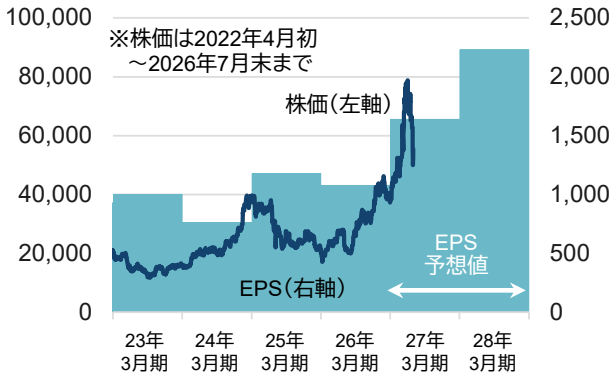
※ 記載の内容はマザーファンドの状況です。
※「市場別構成比率」「規模別構成比率」「投資カテゴリー別構成比率」は、組入銘柄の評価額の合計を100%として計算したものです。
※「業種別構成比率上位」「組入上位10銘柄」は、純資産総額比です。
※ 個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。また、上記銘柄について、将来の組入れを保証するものではありません。
※ 投資カテゴリーはアモーヴァ・アセットマネジメントが考える分類です。当ファンドの投資カテゴリーは上記に限定されるものではなく、将来、変更となる可能性があります。

※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

組入上位銘柄のご紹介①（2026年6月末現在）

東京エレクトロン

＜株価と年間EPSの推移＞
（2023年3月期～2028年3月期予想）



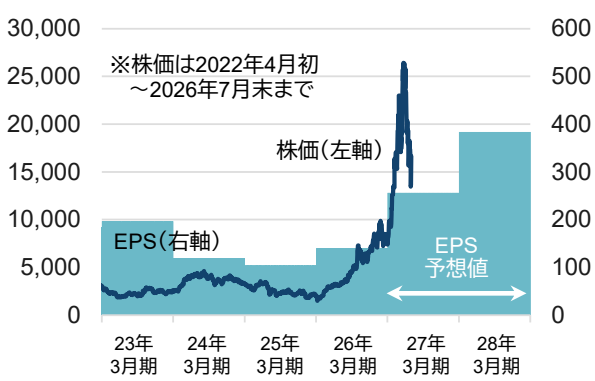
カテゴリー：半導体製造装置・半導体材料企業
業　　種：電気機器
時価総額：26.0兆円
（2026年7月末現在）

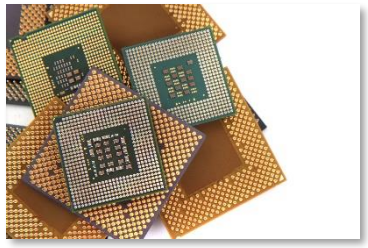
世界トップレベルの半導体製造装置メーカー

- 世界トップレベルの半導体製造装置メーカー。前工程技術にかかわる幅広い製品で高い市場シェアを有します。
- 半導体の製造において、複数の前工程を担う装置に強みを持つ同社は、先端半導体の設備投資が拡大する中で、需要拡大の恩恵を受けるとみられます。加えて、同社は後工程の重要な装置も取り扱っており、後工程技術の進歩に伴なう半導体テストの増加や、微細化以外の方法による高性能化を実現するための技術進化などが、一層の追い風になるとみられます。

イビデン

＜株価と年間EPSの推移＞
（2023年3月期～2028年3月期予想）





カテゴリー：半導体製造装置・半導体材料企業
業　　種：電気機器
時価総額：4.7兆円
（2026年7月末現在）

半導体パッケージ基板の分野で世界的な競争力を持つ

- 半導体や自動車などの分野で世界トップクラスの企業を支える電子部品メーカー。同社は高い技術力を背景に、半導体パッケージ基板の分野で世界最大級のシェアを誇ります。
- 近年、パッケージ技術を活用した、半導体の更なる高性能化が求められています。パッケージ基板の分野では、高多層化や大型化などの技術進化が進んでいるほか、次世代技術への展開も期待されています。今後、パッケージ技術の付加価値が高まるにつれ、同社の収益拡大が見込まれます。

※業種は東証33業種に基づきます。　※EPS（1株当たり利益）予想値は2026年8月現在の市場予想です。　※写真はイメージです。

信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

上記は、当ファンドのマザーファンドの組入上位銘柄について、公開情報など信用できると判断した情報をもとに、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成しています。記載の銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける保有・非保有および将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。
上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

組入上位銘柄のご紹介②（2026年6月末現在）

鹿 島 建 設

＜株価と年間EPSの推移＞
（2023年3月期～2028年3月期予想）

カテゴリー：恩恵を受ける周辺企業
業　　種：建設業
時価総額：2.8兆円
（2026年7月末現在）

高い難易度が求められる半導体工場建設で存在感を示す

- 国内最大級の大手ゼネコン。社会インフラに加え、超高層建築など先駆的なプロジェクトも手掛けています。高度な技術が求められる半導体工場の建設において、同社は大きな存在感を示しています。
- 同社はJASMやRapidusなど、数々の大規模半導体工場の建設を手掛けたことで、高い技術やノウハウを獲得しています。今後も継続的に先端半導体の工場建設が行なわれる可能性が高いことから、こうした状況は同社にとっての追い風になると期待されます。

扶 桑 化 学 工 業

＜株価と年間EPSの推移＞
（2023年3月期～2028年3月期予想）

カテゴリー：半導体製造装置・半導体材料企業
業　　種：化学
時価総額：3,990億円
（2026年7月末現在）

先端半導体におけるCMP工程の拡大が追い風に

- 各種果実酸を製造・販売する果実酸の大手企業であり、ウエハの研磨に使用される超高純度コロイダルシリカを中心とした電子材料事業と、リンゴ酸を中心としたライフサイエンス事業を擁しています。
- 同社の高純度コロイダルシリカは、ナノレベルの精度が要求されるCMP（化学機械研磨）の分野で高い世界シェアを有しています。今後、先端半導体の分野では、配線工程におけるCMP工程の増加に加え、後工程でもCMPの拡大が見込まれることから、同社の収益拡大につながると期待されます。

※業種は東証33業種に基づきます。　※EPS（1株当たり利益）予想値は2026年8月現在の市場予想です。　※写真はイメージです。　信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

上記は、当ファンドのマザーファンドの組入上位銘柄について、公開情報など信用できると判断した情報をもとに、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成しています。記載の銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける保有・非保有および将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。
上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

運用実績(1年決算型)

※当資料において、「1年決算型」は「ジャパン半導体株式ファンド」を指します。

基準価額と純資産総額の推移

(2023年12月22日(設定日)～2026年7月31日)

(2026年7月31日現在)

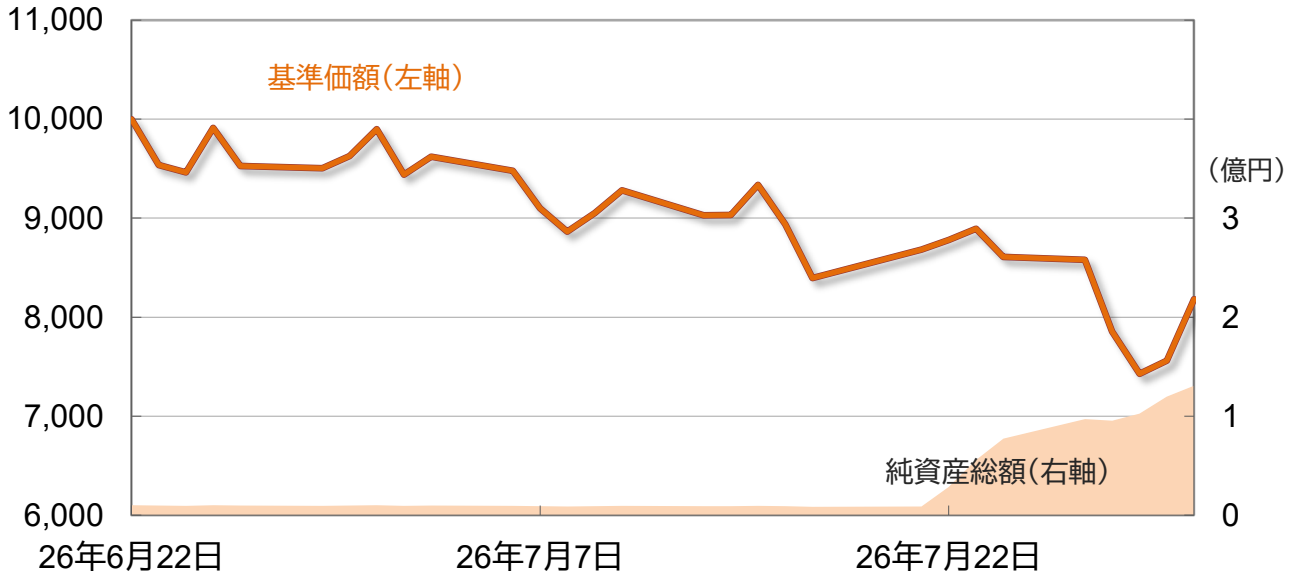
基準価額	26,666 円
純資産総額	348 億円

※ 基準価額は信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の1万口当たりの値です。
※ グラフ掲載期間に分配金支払いの実績はありません。
※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

運用実績（予想分配金提示型）

基準価額と純資産総額の推移

（2026年6月22日（設定日）～2026年7月31日）



（2026年7月31日現在）

基準価額	8,180 円
純資産総額	1.3 億円

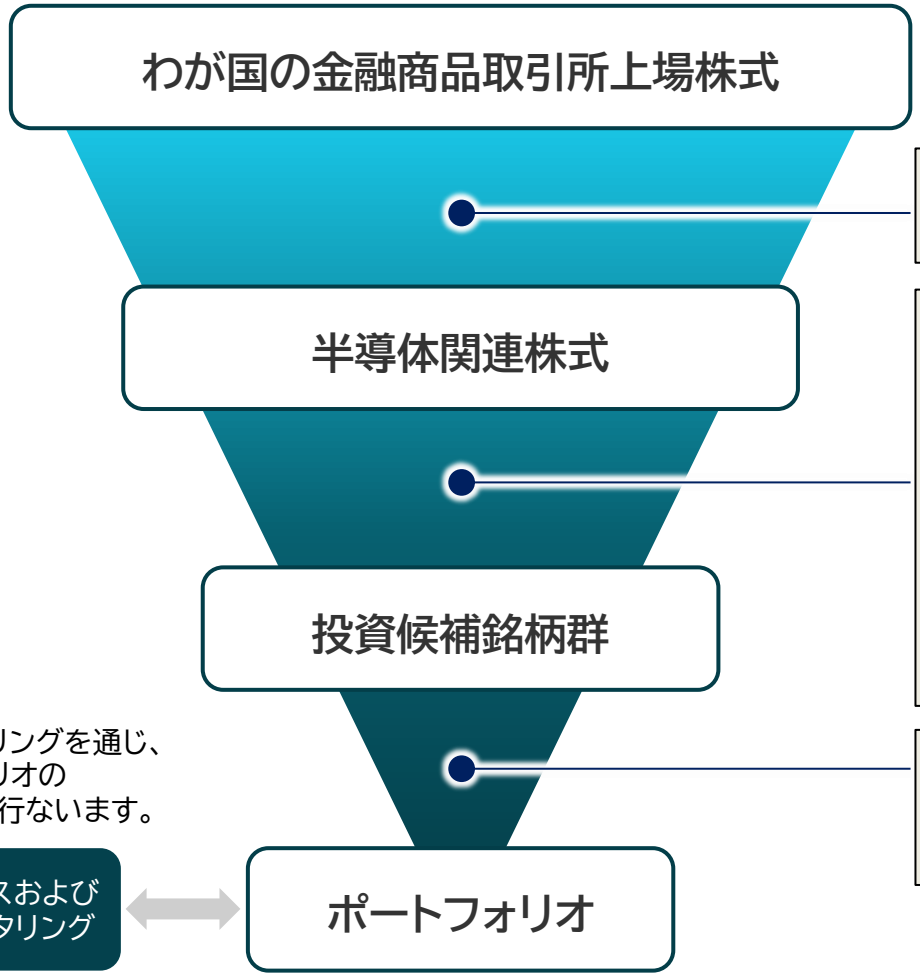
＜分配金実績＞

2026年7月	0円
設定来合計	0円

※ 基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の、分配金は税引前の、それぞれ1万口当たりの値です。
※ 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。
※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

運用プロセス

■ 当ファンドの主な投資対象であるマザーファンドの運用プロセスは、以下の通りです。



時価総額や流動性を考慮したうえで、定性分析により半導体関連ビジネスとの関係性を調査し、投資対象を選定します。

半導体産業に対するトップダウン・アプローチによる調査とボトムアップ・アプローチによる調査を組み合わせ、投資候補銘柄を選定します。

＜トップダウン・アプローチ＞
各種半導体製品の中長期的な需要の変化や半導体製造に用いられる技術の変化など

＜ボトムアップ・アプローチ＞
半導体関連企業の市場シェアの変化や事業構造の変化など

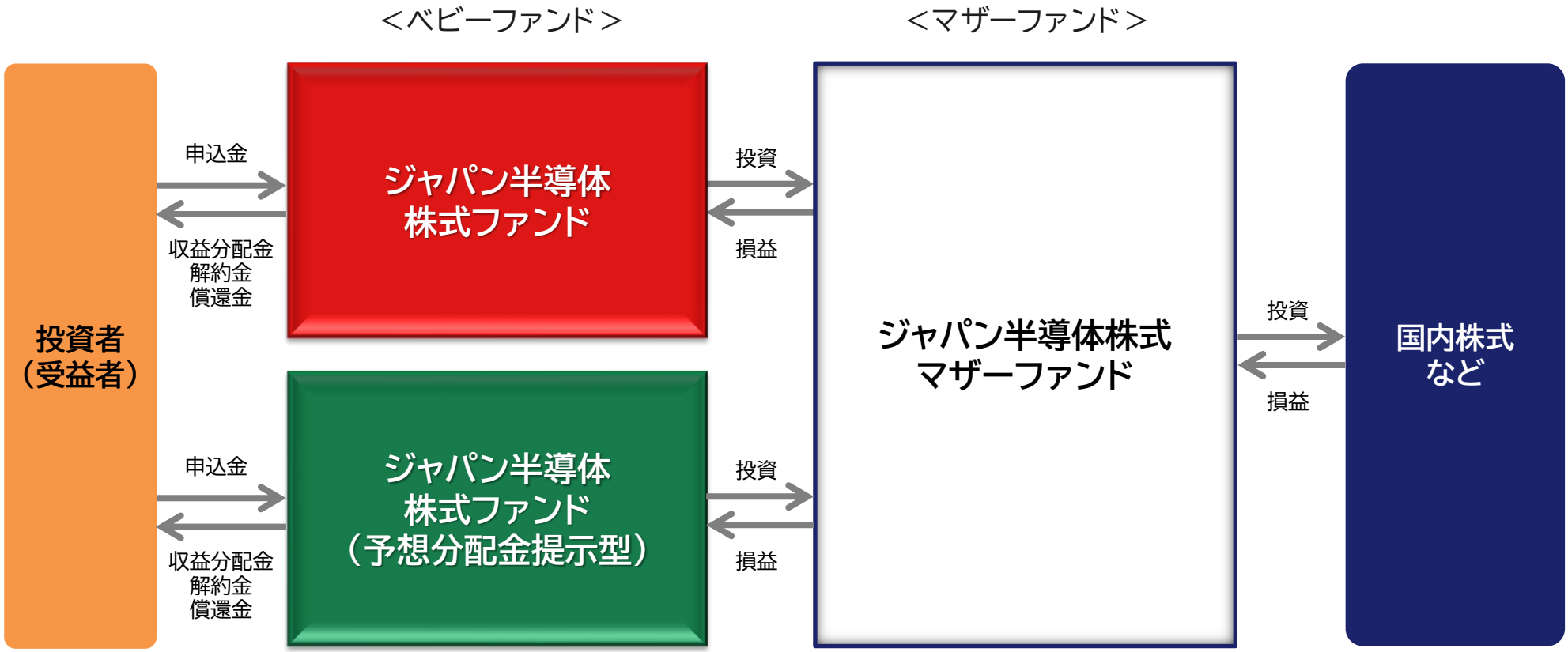
半導体産業における景気循環（シリコンサイクル）や業績モメンタム、バリュエーションなどに着目し、最終的な投資銘柄および投資割合を決定します。

※上記は2026年3月末現在の運用プロセスであり、将来変更となる場合があります。

ファンドの仕組み

■ 当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。

※ ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。



※「ジャパン半導体株式ファンド」の各ファンド間でスイッチングを行なうことができる場合があります。ただし、販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングを行なえない場合があります。

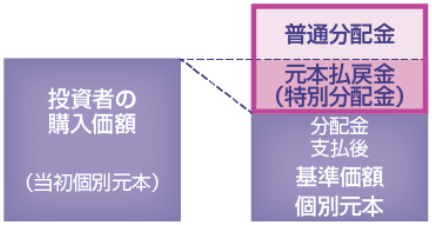
収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

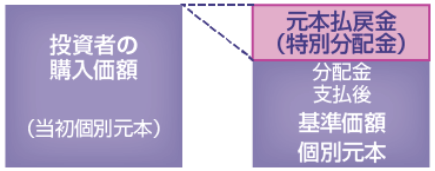
投資信託で分配金が支払われるイメージ

- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

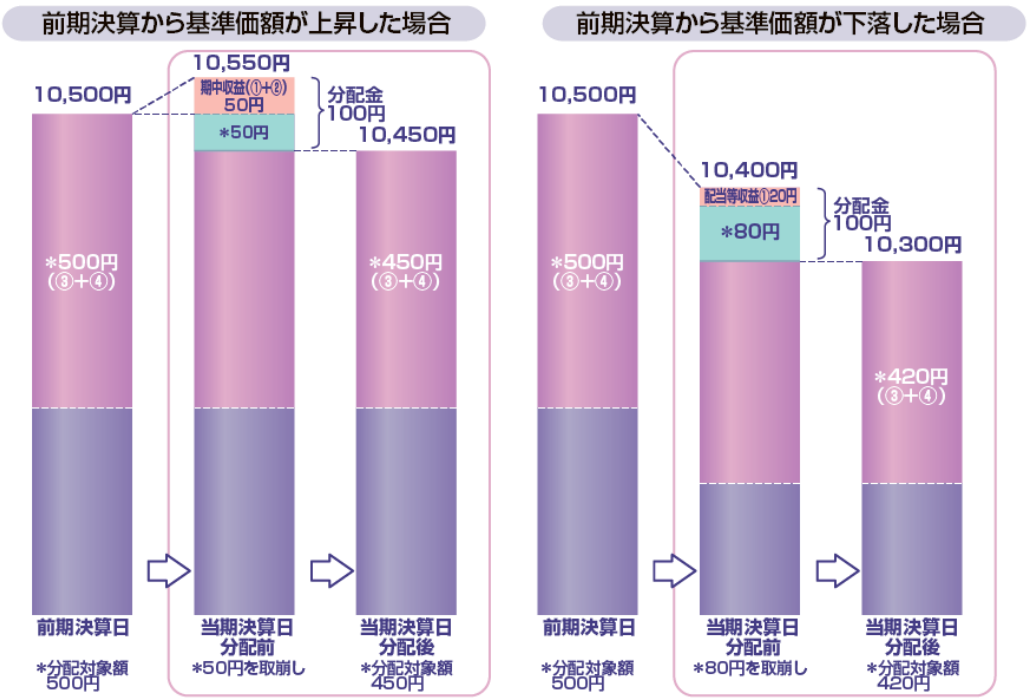


※ 元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

- 普通分配金: 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
- 元本払戻金(特別分配金): 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※ 上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。

お申込みに際しての留意事項①

■ リスク情報

投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

- 株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
- 中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。

流動性リスク

- 市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
- 一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高いと考えられます。

信用リスク

- 投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

為替変動リスク

- 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

(次ページに続きます)

お申込みに際しての留意事項②

（前ページより続きます）

その他の留意事項

- 当資料は、投資者の皆様に「ジャパン半導体株式ファンド」および「ジャパン半導体株式ファンド（予想分配金提示型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

お申込みメモ

※当資料において、「1年決算型」は「ジャパン半導体株式ファンド」を指します。

商品分類	追加型投信／国内／株式
購入単位	販売会社が定める単位 ※ 販売会社の照会先にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額
信託期間	【1年決算型】無期限（2023年12月22日設定） 【予想分配金提示型】2036年6月20日まで（2026年6月22日設定）
決算日	【1年決算型】毎年12月20日（休業日の場合は翌営業日） 【予想分配金提示型】毎月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
換金価額	換金申込受付日の基準価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
課税関係	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。 ※ 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※ 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。 ※「ジャパン半導体株式ファンド」は、NISA の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※「ジャパン半導体株式ファンド（予想分配金提示型）」は、NISA の対象ではありません。 ※ 配当控除の適用があります。 ※ 益金不算入制度は適用されません。

手数料等の概要

投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

＜申込時、換金時にご負担いただく費用＞

購入時手数料	購入時の基準価額に対し3.3%(税抜3%)以内 ※ 購入時手数料(スイッチングの際の購入時手数料を含みます。)は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※ 収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。 ※ 販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。 ≪ご参考≫ (金額指定で購入する場合) 購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額(お支払いいただく金額)となるよう購入口数を計算します。 例えば、100万円の金額指定で購入する場合、指定金額の100万円の中から購入時手数料(税込)をいただきますので、 100万円全額が当ファンドの購入金額とはなりません。 ※上記の計算方法と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 (口数指定で購入する場合) 例えば、基準価額10,000円のときに、購入時手数料率3.3%(税込)で、100万口ご購入いただく場合は、次のように計算します。 購入金額＝(10,000円／1万口)×100万口＝100万円、購入時手数料＝購入金額(100万円)×3.3%(税込)＝33,000円となり、 購入金額に購入時手数料を加えた合計額103万3,000円をお支払いいただくことになります。		
換金手数料	ありません。	信託財産留保額	ありません。

＜信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用＞

運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.584%(税抜1.44%)
その他の費用・ 手数料	目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用、運用において利用する指数の標章使用料などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。 ※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。また、有価証券の貸付は現在行なっておりませんので、それに関連する報酬はかかりません。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 〔ホームページ〕www.amova-am.com 〔コールセンター〕0120-25-1404（午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。）
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
販売会社	投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは 株式会社中国銀行 （登録金融機関　中国財務局長（登金）第2号　加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会） 他

MEMO

amova
アモーヴァ・アセットマネジメント

アセットマネジメント(am)を
ムーヴ(move)する